
股票代码：002288

股票简称：超华科技



广东超华科技股份有限公司

2017 年非公开发行 A 股股票预案

二零一七年七月

发行人声明

一、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

三、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

一、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过，并需经中国证监会核准后方可实施。

二、本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

三、本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 90%（以下简称“发行底价”）。

最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。

四、本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过 186,000,000 股（含本数）。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定发行价格，再确定具体发行股票数量。若公司股票在本次非公开董事会决议公告日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

五、发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。若相关法律、行政法规、规章对发行股票的限售期另有规定的，从其规定。

六、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 88,330.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：

单位：万元

项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）	42,294.16	36,994.00
年产 600 万张高端芯板项目	37,565.93	31,040.00
年产 700 万平方米 FCCL 项目	26,575.29	20,296.00
合计	106,435.38	88,330.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

七、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的有关规定，公司进一步完善了股利分配政策，已制定《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》并经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》及现行有效的《公司章程》，对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年分红规划等，请参见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”，敬请投资者关注。

八、本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金项目有一定的建设周期，且从项目建成投产到产生效益也需要一定的过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险，同时提示投资者，公司虽然为此制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据

此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等情况，请参见本预案“第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析”，敬请投资者关注。

九、本次非公开发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

十、本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

目 录

特别提示.....	2
目 录.....	5
释 义.....	7
第一节 本次非公开发行股票方案概要.....	9
一、发行人的基本情况.....	9
二、本次非公开发行的背景和目的.....	9
三、发行对象及其与公司的关系.....	14
四、本次非公开发行股票方案概要.....	14
五、本次发行是否构成关联交易.....	17
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....	17
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件.....	17
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序.....	17
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....	18
一、本次非公开发行募集资金使用计划.....	18
二、年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）.....	18
三、年产 600 万张高端芯板项目.....	23
四、年产 700 万平方米 FCCL 项目.....	27
五、本次非公开发行对公司的影响分析.....	31
六、可行性分析结论.....	32
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	33
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况.....	33
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....	34
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	34
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....	35
五、本次非公开发行对公司负债情况的影响.....	35
六、本次发行相关的风险说明.....	35
第四节 公司利润分配政策及执行情况.....	37
一、公司利润分配政策.....	37

二、公司未来三年股东回报规划	38
三、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	42

释 义

本预案中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：

一、普通词汇

发行人/公司/本公司	指	广东超华科技股份有限公司
本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票	指	超华科技本次非公开发行不超过 186,000,000 股（含本数）普通股
本预案	指	广东超华科技股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案
最近三年	指	2014 年度、2015 年度、2016 年度
定价基准日	指	发行期首日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	广东超华科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东超华科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东超华科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广东超华科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

二、专业词汇

PCB	指	印制电路板（Printed Circuit Board），采用电子印刷术制作，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。
FPC	指	柔性电路板（Flexible Printed Circuit），是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳的可挠性印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。
HDI	指	高密度互连（High Density Interconnector），使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板。HDI 为专为小容量用户设计的紧凑型产品。
IC 载板	指	集成电路（Integrated Circuit）载板，是载装集成电路的一个载体。
高频覆铜板	指	电磁频率较高的特种线路板，一般来说，高频可定义为频率在 1GHz 以上。其各项物理性能、精度、技术参数要求非常高，常用于汽车防撞系统、卫星系统、无线电系统等领域。
FR4	指	FR4 是一种耐燃材料等级的代号，所代表的意思是树脂材料经过燃烧状态必须能够自行熄灭的一种材料规格，是一种材料等级。

FCCL	指	挠性铜箔基材（Flexible Copper Clad Laminate），又称为：挠性覆铜板、柔性覆铜板、软性覆铜板，FCCL 是挠性印制电路板（Flexible Printed Circuit board/FPC）的加工基材。
PI/TPI	指	聚酰亚胺薄膜/热塑性聚酰亚胺薄膜。是生产 FCCL 的必须原材料。

注：本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人的基本情况

公司名称（中文）：广东超华科技股份有限公司

公司名称（英文）：Guangdong Chaohua Technology Co.,Ltd.

法定代表人：梁健锋

统一社会信用代码：9144140071926025X7

成立日期：1999 年 10 月 29 日

注册资本：931,643,744.00 元

住所：广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号

邮政编码：514759

投资者咨询电话：86-755--83432838

传 真：86-755-83433868

电子信箱：002288@chaohuatech.com

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：超华科技

股票代码：002288

经营范围：制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸制品；货物进出口、技术进出口；投资采矿业；矿产品销售（国家专营专控的除外）；投资与资产管理、企业管理咨询（含信息咨询、企业营销策划等）；动产与不动产、有形与无形资产租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、政策鼓励发展印制电路板

PCB 是现代电子设备中必不可少的基础组件，是各种电子整机产品的重要组成部分，在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对国民经济的发展和国家安全具有十分重要的战略意义，因此我国政府和行业主管部门推出了一系列产业政策对 PCB 行业进行扶持和鼓励，其中主要集中在高密度印刷电路板和挠性板的推动上，具体政策如下表：

时间	文件名称	发布单位	具体内容
2010年10月18日	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	新一代信息技术产业。加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。
2011年6月23日	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	国家发改委、国家科学技术委员会、工信部、商务部和国家知识产权局	优先发展新型元器件中包括高端混合集成电路和高频器件，高密度多层印刷电路板和柔性电路板。
2013年2月16日	《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修改版》	国家发改委	鼓励类中包括：新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造。
2015年3月10日	《外商投资产业指导目录（2015年修订）》	国家发改委、商务部	将“高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板”列入鼓励外商投资产业目录。
2015年3月6日	《2015年工业强基专项行动实施方案》	工信部	关键基础材料工程化、产业化重点支持航空航天用高温合金和记忆合金、核用高纯硼酸、聚四氟乙烯纤维及滤料、高频覆铜板、片式电容器用介质材料等方向，提升材料保障能力。

2、FPC 及 HDI 成为 PCB 行业增长主要动力

FPC 及 HDI 主要应用于包括智能手机在内的移动智能终端市场。以手机为代表的移动智能终端市场规模、发展趋势、出货量直接决定了 FPC 及 HDI 产品的市场需求。市场调研公司 IDC 报告显示，2016 年全球智能手机出货量为 14.71 亿部，年增长 2.32%，其中总销量排名前五的手机厂商分别是三星、苹果、华为、OPPO 和 VIVO，国产手机厂商已经在全球五强中位居三强。

表：2016 年全球市场智能手机销售情况

序号	品牌	2016 年出货量 (亿台)	2015 年出货量 (亿台)	出货量变化 (%)	市场份额变化 (%)	2016 年市场份额 (%)	2015 年市场份额 (%)
1	三星	3.11	3.21	-2.96	-5.16	21.18	22.33
2	苹果	2.15	2.32	-6.95	-9.07	14.65	16.11
3	华为	1.39	1.07	30.19	27.23	9.47	7.45
4	OPPO	0.99	0.43	132.79	127.50	6.76	2.97
5	VIVO	0.77	0.38	103.42	98.80	5.26	2.64
6	其他	6.28	6.97	-9.94	-11.99	42.69	48.50
合计		14.71	14.37	2.32	-	100.00	100.00

数据来源：IDC

2016 年全年，中国市场智能手机销量共 4.67 亿部，同比增长 8.7%，该增幅高于全球同期水平，也远高于 2015 年 1.6% 的增长率。OPPO、华为、VIVO 成为中国智能手机市场全年出货量前三，超过了苹果和三星，小米在国内销量超过了三星位居第五。

表：2016 年中国市场智能手机销售情况

序号	品牌	2016 年出货量 (千万台)	2015 年出货量 (千万台)	出货量变化 (%)	2016 年市场份额 (%)	2015 年市场份额 (%)
1	OPPO	7.84	3.53	122.10	16.78	8.21
2	华为	7.66	6.29	21.78	16.39	14.63
3	VIVO	6.92	3.51	97.15	14.81	8.16
4	苹果	4.49	5.84	-23.12	9.61	13.58
5	小米	4.15	6.49	-36.06	8.88	15.10
6	其他	15.67	17.33	-9.58	33.53	40.31
合计		46.73	42.99	8.70	100.00	100.00

数据来源：IDC

根据科技行业分析公司 Linley Group 发布的最新报告显示，到 2020 年，全球使用的物联网设备将达到 19 亿个。这些接入设备包括仪器、汽车、摄像头、智能手机、可穿戴产品及其他。

随着下游智能终端对性能及轻薄程度的要求越来越高，对 FPC 及 HDI 的需求量也越来越高，据电子行业咨询机构 Prismark 姜旭高博士在 2017 年 3 月

“CPCA 春季论坛”作的报告，2016-2021 年 HDI 板和挠性板（包括刚挠结合板）的年复合增长率超过传统 PCB 产品，分别为 2.8% 和 3.0%。

3、电子设备高频化成为未来发展趋势

随着信息技术的革命，数字电路逐渐步入信息处理高速化、信号传输高频化阶段，为处理不断增加的数据，电子设备的频率变得越来越高，这时基板的性能将严重影响数字电路的特性，因此相关下游行业对 PCB 基板性能提出了新的要求。电子设备高频化的原因主要包括以下三点：

（1）随着我国通信业的快速发展，原有的民用通信频段已经出现拥挤，我国部分军事用途的频段逐渐对民用开放，目前高频通信已经广泛应用于卫星接收、基站、导航、医疗、运输、仓储等领域。（2）高质量信号传输的需求，使移动电话、汽车电话及无线通信向高频化发展。（3）计算机技术处理能力的增加，信息存储容量的增大，迫切要求信号传送高速化。

高频覆铜板主要解决普通覆铜板在通信中微波及毫米波等领域传输性能不稳定及损耗大的高频特性缺陷，是高频印制电路板的核心原材料。高频印制电路板应用领域如下表：

应用领域	适用频段
个人接收基地台或卫星发射	13-24Ghz
汽车防碰撞系统	75Ghz
直播卫星系统	13Ghz
卫星降频器	2-3Ghz
家庭接收卫星	12-14Ghz
全球卫星定位系统（GPS）	1.57/1.22Ghz
汽车、个人接收卫星	2.4Ghz
天线携带通信天线系统	14Ghz
卫星小型地面站	12-145Ghz
数字微波系统	10-38Ghz

4、新能源汽车发展带动锂电铜箔需求

铜箔是一种特殊电解材料，具体为粘合于电路板基板上的一层薄的铜金属箔。主要应用于电路导通、电磁屏蔽及抗静电，具有优良的导通性，并提供电磁屏蔽的效果。铜箔的应用范围非常广泛，电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等新兴领域也离不开铜箔这一基础材料。

随着环境污染问题日益显著，政策鼓励环保、促进节能减排的政策趋势越来越明确，其中新能源汽车则是其中重要的组成部分。中国汽车工业协会发布的最新数据显示，2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7% 和 53%。

高工产研锂电研究所（GGII）预测，受新能源汽车市场驱动，2017-2020 年锂电铜箔的总需求量分别可达 5.42 万吨、6.65 万吨、8.68 万吨、11.42 万吨，年复合增速约 28.2%。而锂电铜箔供给端存量产能严重不足，增量供给提升缓慢，供求两端存在巨大缺口。

综上所述，随着锂电铜箔需求快速增长，我国锂电铜箔市场将出现产能缺口，为行业内锂电铜箔生产企业带来更大的利润空间。

（二）本次发行的目的

1、践行公司“纵向一体化”的发展战略

近年中国经济处在结构调整、转型升级的关键阶段，调整还在持续，实体经济运行仍比较困难，加之世界经济复苏不及预期，贸易持续低迷，且经济运行中的不确定因素在增加。传统印制电路板行业景气度下滑，企业产能过剩，竞争愈发激烈，转型压力日益剧增。但是在常规产品竞争激烈的同时，汽车电子、互联网应用产品及新能源汽车等迅速崛起，给上游电子元器件和材料产业又带来了新的春风。

2015 年公司调整了发展战略，坚持“纵向一体化”产业链发展的同时，向上游原材料产业领域拓展。本次非公开发行股票募集资金的投资方向包括：年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）、年产 600 万张高端芯板项目和年产 700 万平方米 FCCL 项目，是公司发展战略的延续。

2、做大做强主业，完善产品结构，增加市场竞争力

公司在 PCB 行业深耕细作多年，在铜箔基板、铜箔、单/双面覆铜板、单/双面和多层印制电路板等领域有较深厚的积累及市场地位，但总体来说，公司业务主要集中在刚性板领域，以单/双面板及多层板为主。

本次募投项目实施完成后，公司将新增 FR4-HDI 专用薄板、高频覆铜板以

及 FCCL 的生产能力，有效增强公司产品的多样性，完善产品结构，满足下游客户对不同类型产品的需求，为客户提供“一站式”产品服务，增加公司的市场竞争力。

3、加快转型升级，提升公司盈利能力

公司主要从事 PCB、CCL 及其上游的电子铜箔、专用木浆纸等产品的研发、生产和销售。公司是 PCB 行业中少数具有垂直一体化产业链的制造型企业之一，目前公司已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、印制电路专用油墨、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线，并为客户提供“一站式”产品服务。

本次非公开募投项目均为行业内前沿技术，将会引进国内外先进的生产设备，进一步提升公司的盈利能力。

三、发行对象及其与公司的关系

（一）发行对象

本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。

（二）发行对象与公司的关系

本公司尚无法确知上述发行对象与本公司是否存在关联关系。

四、本次非公开发行股票方案概要

（一）发行股票种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内选择适当时机向特定对象发行。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

（四）发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 90%（以下简称“发行底价”）。

最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行底价作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$ 。

其中， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

（五）发行数量

本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过 186,000,000 股（含本数）。在上述发行范围内，由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。

若公司股票在本次非公开董事会决议公告日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

（六）限售期

发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。若相关法律、行政法规、规章对发行股票的限售期另有规定的，从其规定。

（七）募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 88,330.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：

单位：万元

项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）	42,294.16	36,994.00
年产 600 万张高端芯板项目	37,565.93	31,040.00
年产 700 万平方米 FCCL 项目	26,575.29	20,296.00
合计	106,435.38	88,330.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

（八）本次非公开发行股票前滚存利润的安排

本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润由本次非公开发行股票完成

后公司的新老股东按照发行完成后的股份比例共享。

（九）上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

（十）本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告之日，无关联方有意向认购公司本次发行的股票，本次发行不构成关联交易。本次非公开发行的发行对象与公司之间的关系将在本次非公开发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告之日，公司总股本为 931,643,744 股，其中，梁健锋先生和梁俊丰先生合计持有公司 31.03% 的股份，两人为兄弟关系，同为公司的实际控制人。

按照本次非公开发行股票数量上限 186,000,000 股测算，本次发行完成后，梁健锋先生和梁俊丰先生将合计持有公司 25.86 % 的股份，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件

本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于 10%，不存在股权分布不符合上市条件之情形。

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序

公司本次非公开发行 A 股股票方案已于 2017 年 7 月 11 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 88,330.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：

单位：万元

项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）	42,294.16	36,994.00
年产 600 万张高端芯板项目	37,565.93	31,040.00
年产 700 万平方米 FCCL 项目	26,575.29	20,296.00
合计	106,435.38	88,330.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）
- 2、项目建设单位：广东超华科技股份有限公司
- 3、建设地点：广东省梅州市
- 4、项目性质：扩建
- 5、主要产品：6 μ m 电子铜箔、8 μ m-10 μ m 电子铜箔
- 6、项目总投资：项目总投资 42,294.16 万元，其中建设投资 38,871.94 万元，铺底流动资金 3,422.21 万元
- 7、项目建设周期：24 个月
- 8、主要建设内容：在公司自有土地的基础上新建厂房，引进国际先进设备，构建年产能 5,000 吨的电子铜箔生产线，其中 6 μ m 电子铜箔 3,000 吨、8 μ m-10 μ m 电子铜箔 2,000 吨。

（二）项目实施的必要性

1、高精度铜箔是电子铜箔行业的发展方向

电子铜箔根据制造工艺来分，可以分为压延铜箔和电解铜箔。

产品名称	制造工艺类型		应用方向	厚度		
电子铜箔	压延铜箔		铜锭熔炼为铜板后，通过辊压和粗化处理、耐热处理及防氧化处理等一系列表面处理得到	工艺品装饰、挠性电路板（FPC）	≤0.1mm	
	电解铜箔	标准铜箔	铜锭经溶解制成硫酸铜电解液，在直流电作用下电沉积得到	一面光面（S面），一面毛面（M面）	覆铜板（CCL）、印刷线路板（PCB）	5-105μm
		锂电铜箔		两面光面	锂离子电池的负极集流体	6-20μm

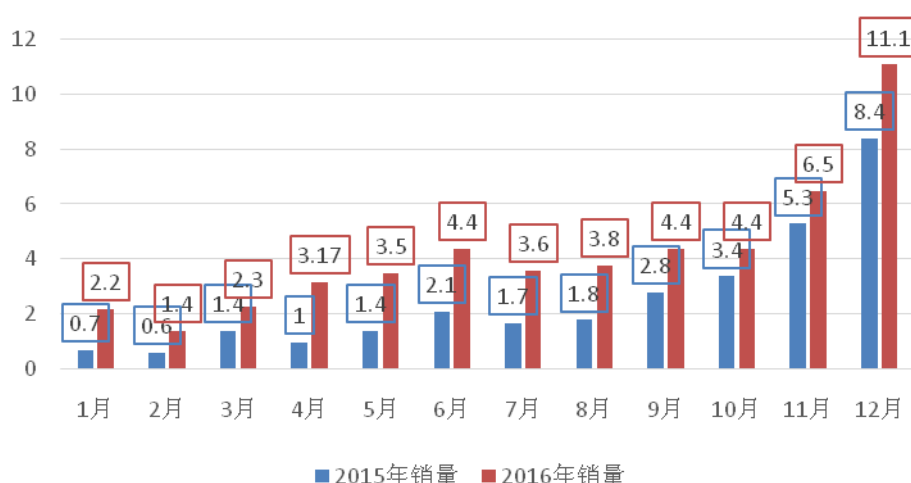
本项目拟采用电解技术制造 6μm 级、8μm-10μm 级高精度电子铜箔，产品可用于新能源汽车动力锂电池负极集流体和印制电路板所需的覆铜板。

标准铜箔经过多年的竞争整合，落后产能逐步淘汰，目前主流产品厚度已经降为 18-35μm。而锂电铜箔主要用作负极材料载体，对产品的一致性和稳定性要求更高，主流厚度为 7-9μm。为了应对将来消费级电子产品轻薄化可穿戴化，锂电池体积小量化、能量密度快速提升的发展趋势，标准铜箔和锂电铜箔的厚度必将进一步压缩，因而高精度铜箔将是电子铜箔发展的必然方向。

2、新能源汽车行业快速发展，锂电铜箔供给出现巨大缺口

2016 年新能源汽车快速发展，有力拉动了锂电池需求。中国汽车工业协会发布的数据显示，2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7% 和 53%。随着 2017 年 6 月 2 日工信部发布第五批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，新能源汽车补贴退坡影响将逐渐消退，根据全国乘用车联合会预计，2017 年新能源汽车销量可达 70 万辆，继续保持高速增长势头。

2015年-2016年新能源汽车销量（万辆）



数据来源：中国汽车工业协会

新能源汽车使用的电池主要为动力锂电池，其具有能量密度高、输出功率大、自重轻、使用寿命长等优点。此外，锂电池的种类还包括用于手机、平板等电子设备的 3C 锂电池，以及用于家庭光储能、基站备用电源、电网储能等用途的广义储能锂电池。

锂电铜箔需求端受动力锂电池拉动，需求增长加速。锂电铜箔是锂电池中不可或缺的重要材料，在锂电池的结构设计中，石油焦和石墨等负极材料需涂敷于导电集流体材料上，锂电铜箔因具有良好的导电性、耐腐蚀性、抗氧化性及原材料成本低廉等特征，成为了锂电池集流体的首选。根据测算，锂电铜箔在动力电池中用量和储能电池中用量约为 900 吨/GWh，在 3C 电池中用量约为 700 吨/GWh，保守预计 2017-2020 年锂电铜箔的总需求量分别可达 5.42 万吨、6.65 万吨、8.68 万吨、11.42 万吨，年复合增速约 28.2%。

表：2016-2020 年锂电铜箔需求量

	2016A	2017E	2018E	2019E	2020E
我国新能源汽车销量（万辆）	50.7	69.7	102.8	146.5	194.6
环比增速（%）	65.69%	37.48%	47.49%	42.51%	32.83%
——动力用锂电池需求（GWh）	25.72	34.74	47.00	67.92	96.68
——3C 用锂电池需求（GWh）	27.00	28.35	29.77	31.26	32.82
——储能用锂电池需求（GWh）	3.16	3.48	3.82	4.21	4.63
锂电池需求量（GWh）	55.88	66.57	80.59	103.39	134.13
——动力电池锂电铜箔需求（万吨）	2.32	3.13	4.23	6.11	8.70

——3C 电池锂电铜箔需求（万吨）	1.89	1.98	2.08	2.19	2.30
——储能用锂电铜箔需求（万吨）	0.28	0.31	0.34	0.38	0.42
锂电铜箔需求量（万吨）	4.49	5.42	6.65	8.68	11.42
环比增速（%）		20.81%	22.75%	30.37%	31.51%

数据来源：高工产研锂电研究所

锂电铜箔供给端存量产能严重不足，增量供给提升缓慢，供求两端存在巨大缺口。锂电铜箔增量供给来自三方面：新增产能、标准铜箔转向锂电铜箔以及国外进口。

（1）从新增产能看：锂电铜箔进入壁垒较高，壁垒主要在于生产设备和工艺。核心设备阴极辊依赖进口，定制和调试周期长，因此锂电铜箔扩产周期在 1.5-2 年左右。同时，铜箔生产环保要求严、投资规模大、运营成本高也制约大规模扩产。

（2）从标准铜箔转产锂电铜箔看：技术上锂电铜箔对产品厚度要求更薄，转产需对现有生产线进行升级改造，而且产成品认证周期较长。市场供求上，标准铜箔需求稳健增长，部分产能转向锂电铜箔后造成供给收缩，也出现供给紧张的局面，因此后续再转到锂电铜箔的空间有限。

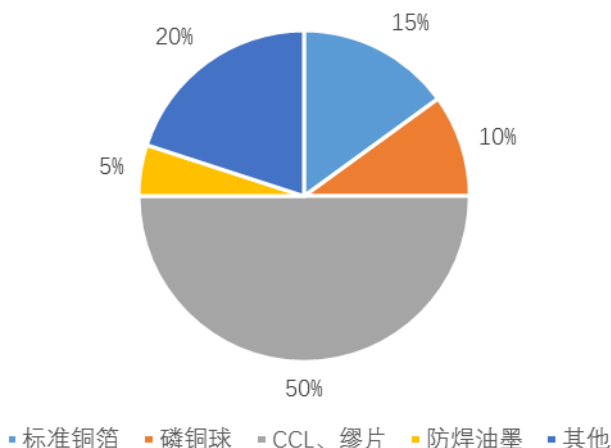
（3）从国外进口来看：目前海外市场供需基本平衡，扩产速度更慢。

综合来看，在新能源汽车和锂电池行业快速发展的推动下，锂电铜箔需求侧增长较快，供给侧受新增产能释放困难的影响增长缓慢，因此锂电铜箔供应短缺局面仍将持续。

3、标准铜箔市场转暖，供需平衡偏紧

PCB 作为电子产品的基础元器件，伴随着下游应用领域消费电子、通讯设备、工控设备、汽车电子、节能照明、智能安防、航空航天及军工产品等领域的快速发展，特别是近几年来汽车电子、小间距 LED、高端服务器等高附加值、高成长性产业的迅猛发展，PCB 产业将进入新一轮景气周期。根据电子行业咨询机构 PrismaMark 统计，2016 年中国大陆 PCB 产值达到 271.04 亿美元，年增长率为 1.43%。标准铜箔是制造 PCB 的主要原材料，在 PCB 产品成本中占据约 15% 的比例，市场空间依旧广阔。

PCB产品成本构成情况



数据来源：中国产业信息网

受锂电池行业快速发展的推动，电子铜箔行业需求回暖明显。由于部分国内外铜箔供应商将部分或全部产能由标准铜箔转移至锂电铜箔，导致目前市场出现锂电铜箔和标准铜箔都供应紧张的局面；另外前次供给侧结构调整后大量国内外厂家转产、出售和关闭，导致大量产能退出 PCB 产品供应链，造成了目前标准铜箔供应偏紧的局面。由于铜箔生产的技术和设备门槛高、投资金额大且扩产周期长，短期之内标准铜箔供应短缺的情况难以缓解，供不应求的情况仍将继续维持。

（三）项目实施的可行性

1、公司在电子铜箔领域拥有较强的技术积累

随着锂电池对锂电铜箔在性能、厚薄度上要求越来越高，铜箔的加工工艺难度也越来越大。由于锂电铜箔生产加工工艺水平较高，对精度要求十分严格，因此锂电铜箔的生产存在较高的技术壁垒。同时高端锂电铜箔的生产设备需要进口，对新进者的资金门槛较高，在资金及技术双重门槛的限制下，预计锂电铜箔市场需求在短期内难以得到满足。

公司是我国较早从事铜箔生产的企业之一，曾参与国家“863 计划”并在过程中积累了一批与铜箔相关的技术及生产工艺。深厚的技术及生产工艺积累为本项目顺利实施打下了坚实的基础。公司取得的电解铜箔相关技术专利情况如下：

序号	专利名称
----	------

1	电解铜箔缓流分液装置
2	电解铜箔真空上液装置
3	一种节能环保电解铜箔生液溶铜装置

2、公司具备完善的销售渠道和优质的合作伙伴，保障产品销售

公司长期从事铜箔产品的生产，与大批客户形成了稳定的合作关系，与多个国内外知名企业展开了深度的战略合作，建立起了覆盖全国各地和海外市场的销售网络。目前公司年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（一期）已于 2017 年 5 月投产，可年产 3000 吨 6-8um 精度的高精度锂电铜箔，在营销渠道方面公司已经做了充分准备。

（四）项目投资估算

本项目总投资 42,294.16 万元，其中建设投资 38,871.94 万元，铺底流动资金 3,422.21 万元；拟使用非公开发行募集资金投入 36,994.00 万元，全部用于固定资产投资。

（五）项目经济效益测算

经测算，本项目内部收益率（税后）为 13.22%，投资回收期（税后）为 8.13 年。

（六）项目报批事项

本项目已取得广东省发展和改革委员会出具的《广东省企业基本建设投资项目备案证》（备案项目编号 111400335129005），以及广东省环保厅出具的关于公司年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程环境影响报告书的批复（粤环审[2011]529 号）。本项目用地已经落实，并办理了国有土地使用权证（梅府国用（2015）第 4811 号）。

三、年产 600 万张高端芯板项目

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：年产 600 万张高端芯板项目
- 2、项目建设单位：梅州超华电子绝缘材料有限公司
- 3、建设地点：广东省梅州市

- 4、项目性质：新建
- 5、主要产品：FR4-HDI 专用薄板、高频覆铜板
- 6、项目总投资：本项目总投资 37,565.93 万元，其中建设投资 32,615.60 万元，铺底流动资金 4,950.33 万元
- 7、项目建设周期：12 个月
- 8、主要建设内容：在公司自有土地的基础上新建厂房，新增年产量 550 万片 FR4-HDI 专用薄板产能及 50 万片高频覆铜板产能。

（二）项目实施的必要性

1、FR4-HDI 板材符合未来市场发展的需求方向

FR4 是一种耐燃材料等级的代号，所代表的意思是树脂材料经过燃烧状态必须能够自行熄灭的一种材料规格，适合应用于高性能电子绝缘要求的产品。目前 FR4 型芯板是 PCB 行业应用领域最广泛的耐燃材料，具备广阔的市场空间。

HDI（High Density Interconnector）高密度互连板，即使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板。HDI 与其他产品的主要区别如下表：

产品类型	主要特性	优点	应用范围
刚性板（RPC, Rigid Printed Circuitboard）	不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印刷线路板	可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑	计算机、网络设备、通讯设备、汽车电子、工控设备、医疗电子
挠性板（FPC, Flexible Printed Circuitboard）	柔性基材制成的印刷线路板	可以弯曲，便于电器部件的组装	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等
金属芯板	金属基材作为底板，表面附上绝缘介质层	散热性好、机械加工性能佳	LED照明、显示、汽车、工业电源设备、通讯设备、音频设备
高密度互联板（HDI, High Density Interconnector）	以常规多层板为芯板，再逐层叠加绝缘层和线路层，使整块印刷电路板形成层间连接	大幅度提高板件布线密度，实现印制板产品的高密度化、小型化发展	手机、笔记本、数码相机等消费类电子产品

电子产品设计在不断提高整机性能的同时，也走向轻薄化、便携化，高密度集成技术在使终端产品满足电子性能和效率等更高设计标准的同时，实现了电子元器件在板材上的集约化。HDI 目前广泛应用于手机、数码（摄）像机、MP3、MP4、笔记本电脑、汽车电子和其他数码产品等，其中以手机的应用最为广泛。

据电子行业咨询机构 Prismark 姜旭高博士在 2017 年 3 月“CPCA 春季论坛”作的报告，2016-2021 年 HDI 板和挠性板（包括刚挠结合板）的年复合增长率超过传统 PCB 产品，分别为 2.8% 和 3.0%。

2、满足 PCB 行业的尖端需求

高频覆铜板，即电磁频率在 1GHz 以上的特种线路板。其各项物理性能、精度、技术参数要求非常高，常用于卫星接收器、基地天线、微波传输、汽车电话、全球定位系统、卫星通信、通信器材转接器、接收器、信号振荡器、家庭电器联网、高速运行计算机、示波器、IC 测试仪器等等，以及高频通信、高速传输、高保密性、高传送质量、高记忆容量处理等通信和计算机领域。

2015 年 3 月 6 日，工信部印发《2015 年工业强基专项行动实施方案》中明确提到“关键基础材料工程化、产业化重点支持航空航天用高温合金和记忆合金、核用高纯硼酸、聚四氟乙烯纤维及滤料、高频覆铜板、片式电容器用介质材料等方向，提升材料保障能力。”

随着终端市场对高保密性、高传送质量的追求，使得移动电话、汽车电话，无线通信向高频化发展。同时，高信息量传送、卫星通信的使用频率将会提高，倒逼微波通信和光纤通信必须高频化，市场对高频覆铜板的需求将会越来越大。

3、提升产品技术含量、维持行业竞争地位

刚性覆铜板当前仍是公司的主要创收产品，2016 年全年覆铜箔板的营业收入占比达到 32.52%。随着中低端覆铜板逐渐更新换代，如不能迅速调整产品结构，公司在将来的市场竞争中将面临十分被动的局面。为了保持与市场需求发展趋势相匹配，公司必须加大新型覆铜板的投入，尽快具备高精密电路板的生产能力，提升 FR4-HDI 专用薄板和高频覆铜板的产能规模，以保持公司未来的长期快速发展，实现利润增长与市场开拓的良性循环，进一步巩固公司的市场竞争地位。

（三）项目实施的可行性

1、公司具有多年覆铜板生产经验

经过二十年的积累和创新，公司已经形成一系列成熟的企业管理体系，为公司生产经营和发展覆铜板业务提供了强有力的人才、体系的保障。同时经过多年的覆铜板生产所累积下来的工艺技术，都是确保本项目顺利实施的前提。

2、公司具有完善的覆铜板销售团队及网络

公司凭借稳定的产品质量、准时的交货期，继续强化市场营销推广，深挖已有市场资源，与骨干客户飞利浦、美的空调、欧普光电、松下、立讯精密、依顿、宏仁、胜宏科技、奥斯康等多个国内外知名企业深度的战略合作。

公司通过使用销售管理移动终端平台，降低因子公司分处多地导致销售人员分布分散、沟通缺失等引发的营销管理效率低的风险。同时，公司非常重视营销队伍建设，通过建立垂直产业链上各细分市场的营销体系和对各子公司内部建立差异化的管理体系，公司整体发挥研发、市场、技术支持和服务资源协同效应，稳步推进市场开发，不断扩大市场占有率。公司完善的营销网络和队伍，是本项目实施的重要保障。

3、完善的技术研发体系

公司与哈尔滨理工大学等研发机构成立高频覆铜板共同研发项目，并已经取得相关研发成果，为本项目顺利实施提供了技术保障。

（四）项目投资估算

本项目总投资 37,565.93 万元，其中建设投资 32,615.60 万元，铺底流动资金 4,950.33 万元；拟使用非公开发行募集资金投入 31,040.00 万元，全部用于固定资产投资。

（五）项目经济效益测算

经测算，本项目内部收益率（税后）为 13.16%，投资回收期（税后）为 7.69 年。

（六）项目报批事项

本项目已取得梅州市梅县区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2016-441421-39-03-010188）以及梅州市环境保护局出具的关于梅州超华电子绝缘材料有限公司年产 600 万张高端芯板项目环境影响报告

书的批复（梅市环审[2017]28 号）。本项目用地已经落实，并办理了国有土地使用权证（梅府国用（2015）第 4811 号）。

四、年产 700 万平方米 FCCL 项目

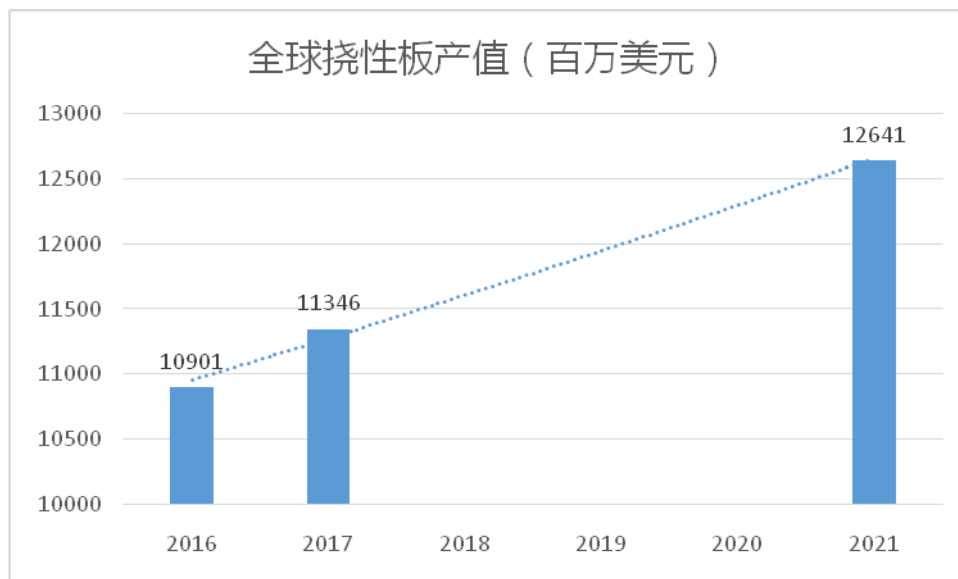
（一）项目基本情况

- 1、项目名称：年产 700 万平方米 FCCL 项目
- 2、项目建设单位：梅州超华电子绝缘材料有限公司
- 3、建设地点：广东省梅州市
- 4、项目性质：新建
- 5、主要产品：3-FCCL（有胶）、2-FCCL（无胶）、覆盖膜
- 6、项目总投资：项目总投资 26,575.29 万元，其中建设投资 21,359.45 万元，铺底流动资金 5,215.84 万元
- 7、项目建设周期：12 个月
- 8、主要建设内容：在公司自有土地的基础上新建厂房，引进国际先进设备，新增 700 万平方米 FCCL 及 500 万平方米覆盖膜产能。

（二）项目实施的必要性

1、挠性覆铜板（FCCL）是 PCB 行业的重要原材料

近年来，以智能手机、平板电脑等移动电子设备为主的消费类电子产品市场高速增长，极大地推动了作为其主要连接配件的挠性印制电路板（FPC）市场发展。根据电子行业咨询机构 PrismaMark 发布的数据表明，2016 年全球 PCB 行业总产值 542.07 亿美元，细分品类中 FPC 总产值为 109.01 亿美元，占比 20.11%。预计 2021 年 FPC 年产值将达到 126.41 亿美元，占比可进一步上升至 20.92%。



数据来源：Prismark

FPC 中的重要原材料之一就是 FCCL。传统的 FCCL 产品是由铜箔、薄膜、胶粘剂三个不同材料、不同功能层所复合而成的，因此又称它为“三层型挠性覆铜板”（3-FCCL）。近几年，有一种产品结构的 FCCL 在应用方面得到很快的发展，这就是无胶粘剂的挠性覆铜板，称为“二层型挠性覆铜板”（简称“2-FCCL”）。2-FCCL 与 3-FCCL 相比，具有耐温性能更好、尺寸稳定性更好、抗剥离强度更高、更加薄型化、耐折性更好等性能特点。3-FCCL 与 2-FCCL 性能指标及应用领域具体如下表：

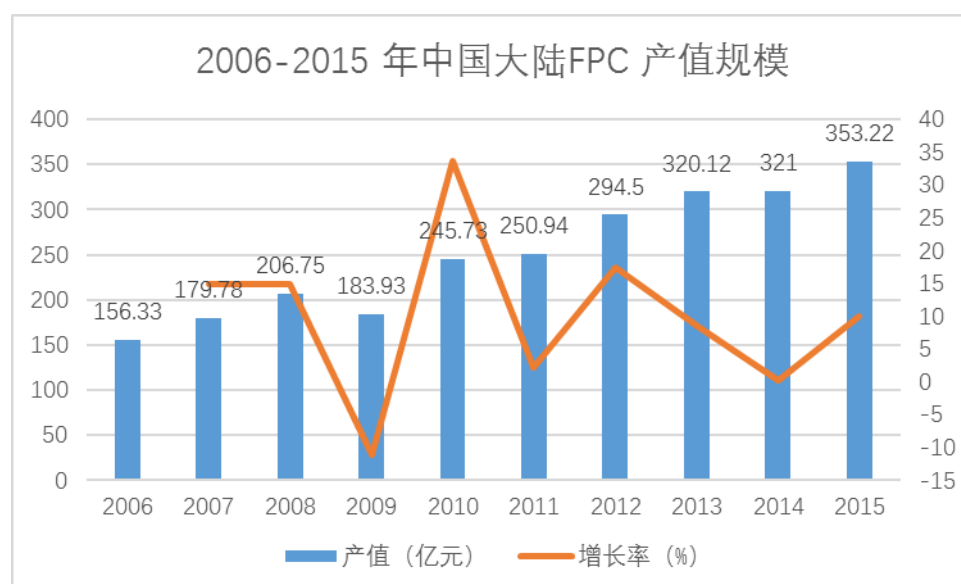
产品类型	最小厚度 (mm)	抗剥离强度 (kgf/cm)	尺寸稳定性 (%)	适用领域
3-FCCL	39	1	0.08	汽车、LED、手机、电脑与周边、医疗和检测仪器等
2-FCCL	30	1.1	0.06	汽车、手机、电脑与周边、摄影器材、智能手表和手环、航空等

目前，由于智能终端轻薄化的趋势越来越明显，市场对于高端 2-FCCL 的需求量将会越来越大，与此同时，3-FCCL 依然具有较大的存量市场，例如：汽车、LED、手机等电子产品的 FPC 依然以 3-FCCL 为主要原材料。

总体来说，FPC 是 PCB 行业的主要发展趋势之一，本项目实施后公司将具备 2-FCCL 及 3-FCCL 的生产能力，对公司顺应行业发展趋势、巩固 PCB 行业地位具有重大意义。

2、紧抓 FPC 行业向大陆地区转移的机遇

近年来，日本、韩国和台湾生产成本持续攀升，FPC 产业开始了新一轮的产业转移。发达国家的 FPC 制造商纷纷在中国投资设厂，中国作为 FPC 产业主要承接国，在新一轮产业转移浪潮中受益。目前，中国地区 FPC 产值占全球产值的比值不断提升，已从 2005 年的 6.74% 提高至 2015 年的 47.97%，处于全球领先地位。



数据来源：中国产业信息网

受全球 FPC 产业转移的影响，大陆地区 FPC 产值持续保持高速增长，2006-2015 年年均复合增长率达 8.49%。FPC 产能向大陆地区的不断集中，带动 FPC 产品的主要原材料 FCCL 市场将进一步向大陆地区集中，国内 FCCL 产品供应商将从中获益。

根据中国覆铜板材料协会（CCLA）统计，2016 年全国 FCCL 产品及相关制品销售收入 25.57 亿元，销售数量达 5,437 万平方米，较 2015 年同比增长 6.70%，取得了较大增长。同时，随着国产 FCCL 产品技术含量的不断提高，进口替代率将不断上升，我国 FCCL 产业市场规模将取得进一步突破。

3、完善公司产业链，优化产品结构

公司始终坚持走“科技创新”发展的道路，坚持“纵向一体化”的产业链滚动发展战略，产品覆盖包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层电路板、覆铜板专用木浆纸、印制电路专用油墨、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线，为客户提供“一站式”产品服务。

目前公司的业务核心主要在刚性板领域，着手布局 FCCL 产业是公司完善柔性线路板行业产品布局的新起点，同时也是公司发掘新盈利增长点的重要举措。

（三）项目实施的可行性

1、引进国际先进设备，生产工艺成熟

公司将从日本引进国际先进的 FCCL 生产设备，构建产能、性能达到国际水平的高端 FCCL 生产线，以保证公司生产的 FCCL 在品质上具有较强的市场竞争力。同时，公司本次 FCCL 项目将采用工艺较为成熟的层压法进行生产，以保证生产速率，保障产品质量稳定可靠。在本项目实施前，公司对生产设备及生产工艺方面已经做了充分的调研及论证，本项目实施不存在实质性障碍，具有可行性。

2、通过加大研发，满足 FCCL 原材料需求

FCCL 产品的主要原材料包括聚酰亚胺薄膜(PI)、热塑性聚酰亚胺薄膜(TPI)和高精度电子铜箔等。

为确保公司产品质量，目前公司 FCCL 项目计划以进口原材料为主，但公司将同时加大对聚酰亚胺薄膜及热塑性聚酰亚胺薄膜的研发投入，加深公司在 FCCL 原材料领域的技术积累，为实现关键原材料的自主供给提供保证。

同时，随着下游终端应用领域对于 FCCL 轻薄的需求越来越高，厚度 9 μ m 以下的压延铜箔因受其生产工艺的限制，铜箔性能将会发生改变，难以满足 FCCL 的生产需求。因此在 9 μ m 规格以下的超薄 FCCL 领域，电解铜箔将取代压延铜箔的应用。公司已进入试产阶段的“年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程”项目（一期）中已预留部分产能用于 FCCL 专用铜箔的生产，此举将进一步保障公司 FCCL 产品的市场竞争力以及产品稳定性，为本项目顺利实施提供了保障。

3、对行业的深度理解，充分了解客户需求

公司是 PCB 行业中少数具有垂直一体化产业链的制造型企业之一，深入了解 PCB 行业全产业链的市场发展状况。

FPC 是 PCB 领域中最具发展潜力的细分领域。据 Prismark 预测，2017 年挠性板的产值年增长率为 4.1%，增长幅度在五大 PCB 品种中位居第一。2021 年 FPC 仍成为需求增长最大的品种，其在 PCB 各类品种的总产值所占的比例，将

由 2016 年的 20.1%，提升到 20.9%。

公司所生产的 FCCL 将在满足下游客户需求的基础上，不断与时俱进，以公司研发中心为核心加大相关研发投入，包括对国际领先的化学法及涂布法进行开发，以满足下游客户对 FCCL 轻薄性能的需求。

4、丰富的制造业管理经验

公司自成立以来一直从事 PCB 相关材料和产品的生产制造，公司管理层具有丰富的生产管理相关经验，同时公司本次引进的生产设备自动化程度高，保障了本项目生产产品的良品率，为本项目实施提供了可行性。

（四）项目投资估算

项目总投资 26,575.29 万元，其中建设投资 21,359.45 万元，铺底流动资金 5,215.84 万元；拟使用非公开发行募集资金投入 20,296.00 万元，全部用于固定资产投资。

（五）项目经济效益测算

经测算，本项目内部收益率（税后）为 14.15%，投资回收期（税后）为 7.94 年。

（六）项目报批事项

本项目已取得梅州市梅县区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2016-441421-39-03-010189）以及梅州市环境保护局出具的关于梅州超华电子绝缘材料有限公司年产 700 万平方米 FCCL 项目环境影响报告书的批复（梅市环审[2017]29 号）。本项目用地已经落实，并办理了国有土地使用权证（梅府国用（2015）第 4811 号）。

五、本次非公开发行对公司的影响分析

（一）本次发行对公司经营管理的影响

通过本次非公开发行，公司的资本实力与生产规模将进一步提升，产业链将得到扩展，产品结构将得到优化。本次非公开发行将有利于公司巩固市场地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产总额将同时增加，资金实力将得到有效提升；另一方面，由于本次发行后总股本将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法体现，因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的可能性。但是，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。

通过本次非公开发行募集资金，公司的资产负债率将有所下降，流动比率及速动比率将有所上升，这将有利于优化公司的资产负债结构，降低公司的财务风险，并为公司后续债务融资提供良好的保障，增强公司长期持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

六、可行性分析结论

本次非公开发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位，符合全体股东的根本利益。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

析

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况

（一）本次发行后公司业务及资产变化情况

公司本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司未来发展战略布局展开。项目实施后，公司将进一步增强上游高端原材料的生产能力，助推公司实现战略升级、“纵向一体化”的业务布局，扩大公司业务规模，将有利于公司优化产品结构，巩固市场地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，增强公司主营业务盈利能力，促进公司的长期可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，且不涉及资产收购事项，不会导致公司业务和资产的整合。

（二）本次发行后公司章程变化情况

本次非公开发行完成后，公司股东结构和注册资本将发生变化，公司将根据发行结果对公司章程中的相应条款进行修改，并办理工商变更登记。

（三）本次发行后对股东结构变化情况

截至本预案公告之日，公司总股本为 931,643,744 股，其中，梁健锋先生和梁俊丰先生合计持有公司 31.03% 的股份，两人为兄弟关系，同为公司的实际控制人。

按照本次非公开发行股票数量上限 186,000,000 股测算，本次发行完成后，梁健锋先生和梁俊丰先生将合计持有公司 25.86% 的股份，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

（四）本次发行后高管人员变化情况

截至本预案公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行后公司业务收入结构变化情况

本次非公开发行前，公司主营业务收入构成主要为印制电路板、覆铜箔板、铜箔等。本次非公开发行募集资金投资项目建设完成后，公司将新增锂电铜箔、FCCL 及高频覆铜板等高端上游原材料的生产能力，将有利于增强公司现有主营业务的综合竞争力。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所降低，有利于进一步增强公司资本实力，优化资本结构，降低财务风险，有利于公司的稳健经营和持续健康发展。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

由于本次发行后公司净资产和总股本将有所增加，而募集资金投资项目产生的经营效益需根据项目开发进度逐步体现，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着项目实施，公司营业收入和净利润预计将有较大的增长，有利于提升公司的盈利能力以及增强公司的可持续发展能力。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行由特定对象以现金认购，募集资金到位后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，公司资本实力将得以提升。随着募集资金投资项目的实施和效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。公司的总体现金流量将有所改善。

三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均未发生变化。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、本次非公开发行对公司负债情况的影响

本次发行完成后，公司的资产负债率将有所降低，资产负债结构将更趋稳健，抵御风险能力将进一步增强，公司低负债的经营策略有效控制了财务费用水平并确保未来融资渠道的畅通，降低了募投项目建设及运营的风险，为公司未来业务的发展提供有力保障。公司不存在财务成本不合理的情况。

六、本次发行相关的风险说明

（一）募集资金投资项目建设风险

本次非公开发行募集资金将用于年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）、年产 600 万张高端芯板项目、年产 700 万平方米 FCCL 项目的建设。在项目实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，造成项目不能按期建设、项目达产延迟等不确定情况，最终导致募集资金投资项目投资周期延长、投资超支、投产延迟，从而影响项目预期效益。

（二）技术风险

本次非公开发行募集资金拟投资项目对实施主体的技术要求、生产设备的精度要求和技术人员的熟练度要求均较高，并且项目的生产过程中也存在较高的技术风险，例如大规模量产过程中工艺技术的研究、工艺条件的试验及确定等。若本项目投产过程中技术方面不达标，可能会造成本项目投产期延长、成品率降低、项目利润率及回收期不及预期等不利影响。

同时，公司保持核心竞争力关键是技术，核心技术人员的流失将导致核心技术或生产工艺的流失，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

（三）市场风险

本项目投产后，公司将新增 FCCL、高频覆铜板等新产品，虽然本次募集资金投资项目系经过公司充分市场调研以及慎重的可行性研究论证后确定，但不排

除受宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，市场容量增速低于预期或发行人市场开拓不力，可能出现项目实际经济效益不能达到预期经济效益的风险。

（四）表决权被摊薄的风险

本次发行将增加公司股份，原公司股东（特别是控股股东及实际控制人）在股东大会上所享有的表决权会相应被摊薄，从而存在表决权被摊薄的风险。

（五）摊薄即期回报的风险

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金项目有一定的建设周期，且从项目建成投产到产生效益也需要一定的过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险，同时提示投资者，公司虽然为此制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

（六）审批风险

本次非公开发行方案尚需经公司股东大会审议批准以及中国证监会核准，公司本次非公开发行能否取得相关批准及核准，以及最终取得批准及核准的时间存在一定不确定性。

（七）股票价格波动风险

股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家的经济政策、经济周期、通货膨胀、股票市场的供求状况、重大自然灾害的发生、投资者心理预期等多种因素的影响。因此，本公司的股票价格存在若干不确定性，并可能因上述风险因素而出现波动，股票价格的波动会直接或间接地给投资者带来投资收益的不确定性。

第四节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

根据《公司章程》第一百五十五条，公司利润分配政策如下：

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；但在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

（三）利润分配时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。

（四）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；

公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润为正值；

2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

4、公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)，可以降低分红比例。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

若公司当年亏损但累计未分配利润为正值，且同时满足上述第 2 至第 4 款之条件时，如董事会认为必要，经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事审议通过提请股东大会批准，公司可以进行现金分红。

(六) 发放股票股利的具体条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采用股票股利方式进行利润分配。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(七) 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、公司未来三年股东回报规划

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、中国证监会《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》(以下简称“本规划”)。本规划已经公司第四届董事会第二十七次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下：

(一) 本规划制定的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司未来三年（2017—2019 年）将采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；但在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

（二）本规划考虑因素

综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。

充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素。

平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。

（三）利润分配政策

1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；但在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

3、利润分配时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。

4、现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、现金分红的条件

(1) 公司该年度实现的可分配利润为正值；

(2) 审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(4) 公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以降低分红比例。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5000 万元人民币。

若公司当年亏损但累计未分配利润为正值，且同时满足上述第 2 至第 4 款之条件时，如董事会认为必要，经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事审议通过后提请股东大会批准，公司可以进行现金分红。

6、发放股票股利的具体条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采用股票股利方式进行利润分配。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

7、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(四) 利润分配政策的决策程序

1、公司年度的股利分配方案由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，独立董事应对分红预案独立发表意见，公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；

2、在符合国家法律、法规及《公司章程》规定的情况下，董事会可提出分配中期股利或特别股利的方案，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；

3、监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事通过，并在公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事（若有）和监事会的审核意见；

4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；

5、公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；

6、公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

7、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交股东大会审议批准。

（五）股东回报规划的制定周期和决策机制

1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。

2、若因公司外部经营环境发生重大变化、公司自身经营状况发生重大变化，或现行的利润分配规划影响公司的可持续经营，以及因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规划的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。

（六）未来三年（2017-2019 年）具体股东回报规划

1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、未来三年内，如果公司达到现金分红条件，将积极采取现金分红的方式进行利润分配，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。未来三年，公司正处于转型的关键时期，为了满足公司转型所需资金，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。

3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

三、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况

（一）公司最近三年利润分配情况

最近三年，公司现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
现金分红额（含税）	-	279.49	465.82
归属于母公司所有者的净利润	-6,193.43	2,598.41	747.78
现金分红/当期归属于母公司所有者的净利润	-	10.76%	62.29%

（二）公司最近三年未分配利润使用情况

最近三年公司实现的归属于上市公司股东的净利润在向股东分配后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营。

（本页无正文，为《广东超华科技股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案》之盖章页）

广东超华科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 11 日